

tesa HAF® 8440 HS



Information Produit

Film activable à chaud pour l'intégration des modules dans les cartes à puces

Description produit

tesa® HAF 8440 est un film adhésif translucide double face, activable à chaud, composé de copolyamide thermoplastique.

Application

tesa® HAF 8440 convient particulièrement à l'implantation de puces électroniques dans les cartes à puces.

- convient aux cartes PVC, ABS et PC
- facilement utilisable sur les machines d'implantation classiques
- bonne résistance au vieillissement
- invisible sur la carte assemblée

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------|
| • Support | aucun | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | co-polyamide | • Epaisseur totale | 40 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Force de collage | 12 N/mm ² |
|--------------------|----------------------|

Infos complémentaires

Recommandations techniques:

Les valeurs suivantes sont recommandées pour le paramétrage des machines. Veuillez noter que les paramètres optimaux dépendent énormément du type de machine, des matériaux particuliers pour les coques des cartes et des modules de puces ainsi que des exigences des clients.

- Pré laminage :

L'adhésif est laminé sur le substrat en métal. Cette étape peut être effectuée en ligne ou en dehors. L'étape de pré-laminage n'affecte pas la durée de conservation. Les rouleaux de modules laminés se conservent comme l'adhésif seul.

Paramètres de la machine

- Température: 130 – 140°C
- Pression: 4 – 6 bar
- Durée: 1,5 – 3,0s

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa HAF® 8440 HS

Information Produit

Infos complémentaires

2. Implantation du module: Pendant l'étape d'implantation, les modules ayant été prédécoupés, sont placés dans les cavités créées à cet effet et collés de façon permanente sur le corps de carte. Pour cette étape, les paramétrages dépendent du type de ligne utilisée. Aujourd'hui, deux procédés sont couramment utilisés :

Procédé en une seule étape (machine à basse température):

- Température¹ 160 – 190 °C
- Pression 65 N/module
- Durée 2,0 – 4,0 s

Procédé en une seule étape (machine à haute température):

- Température¹ 180 – 210 °C
- Pression 65N/module
- Durée 1,0 – 1,5 s

Procédé à plusieurs étapes avec 2 ou plusieurs pressions à chaud:

- Température¹ 180 – 200 °C
- Pression 65N/module
- Durée pour chaque étape 0,7 – 1,2 s

Les températures sont mesurées sur le tampon chauffant

Les conditions de stockage sont faites selon les conditions de la gamme HAF.

Note: les valeurs de pouvoir adhésif sont obtenues selon des conditions standard en laboratoire (valeurs moyennes). Les valeurs sont garanties et données pour chaque numéro de lot (matériel: pièce en aluminium repéré/conditions de collage: température: 120°C; pression: 10 bar; durée: 8 min)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=8440>